

台灣積體電路製造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
公開說明書(申報用之稿本)
(發行 111 年度第 5 期無擔保普通公司債)

- 一. 公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司
- 二. 本公開說明書編印目的：發行 111 年度第 5 期無擔保普通公司債。
- 三. 發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：
 - (1) 種類：無擔保普通公司債。
 - (2) 金額：新臺幣 156 億元整。
 - (3) 利率：本公司債票面利率為甲類固定年利率 1.65%，乙類固定年利率 1.65%，丙類固定年利率 1.65%，丁類固定年利率 1.82%。
 - (4) 發行條件：
 1. 名稱：台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 5 期無擔保普通公司債。
 2. 發行總額：發行總額為新臺幣 156 億元整。本公司債依發行期限之不同分為甲類、乙類、丙類及丁類 4 種。甲類 4 年 10 個月無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 20 億元整，乙類 5 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 89 億元整，丙類 7 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 22 億元整，丁類 10 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 25 億元整。
 3. 票面金額：新臺幣壹仟萬元壹種。
 4. 發行期間：本公司債發行期限為甲類 4 年 10 個月，乙類 5 年期，丙類 7 年期，丁類 10 年期。
甲類自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 116 年 6 月 日到期。
乙類自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 116 年 8 月 日到期。
丙類自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 118 年 8 月 日到期。
丁類自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 121 年 8 月 日到期。
 5. 發行價格：依票面金額十足發行。
 6. 還本方式：各類券均為到期一次還本。
 7. 計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。計息基礎依實際天數/該年度實際總日曆天數計算。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
 8. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
 9. 債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
 - (5) 公開承銷比例：百分之百對外公開承銷。
 - (6) 承銷及配售方式：委託承銷商對外公開承銷(洽商銷售)。
 - (7) 銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 四. 本次資金運用計畫之用途及可能產生效益概要：用途為新建擴建廠房設備，預計可能產生效益請參閱本公開說明書參、資金用途。
- 五. 本次發行之相關費用：
 - (1) 承銷費用：新臺幣 15,600 仟元整。
 - (2) 其他費用：約新臺幣 340 仟元。
- 六. 有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七. 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八. 股票面額：每股面額新臺幣 10 元整。
- 九. 投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
- 十. 查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新臺幣仟元

資 本 來 源	金 額	佔 實 收 資 本 額 比 率
創 立	1,377,500	1%
現 金 增 資	16,888,171	7%
盈 餘 轉 增 資	241,738,691	93%
資 本 公 積 轉 增 資	7,901,337	3%
合 併 增 資	15,835,152	6%
減 資	(27,569,238)	(11%)
其 他	3,132,192	1%
合 計	259,303,805	100%

二、公開說明書之分送計劃：

- (一) 陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。
 (二) 分送方式：依證券主管機關之規定辦理
 (三) 索取處所：請附回郵信封向本公司索取或逕洽公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)

三、公司債承銷商名稱、地址、網址及電話：

名 稱	群益金鼎證券股份有限公司	網 址	https://www.capital.com.tw
地 址	台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓之 3	電 話	(02)8789-8888

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	台北富邦商業銀行股份有限公司	網 址	http://www.fubon.com
地 址	台北市仁愛路四段 169 號	電 話	(02)2771-6699

六、公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	中國信託商業銀行 代理部	網 址	https://www.ctbcbank.com
地 址	台北市重慶南路一段 83 號 5 樓	電 話	(02) 6636-5566

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱	中華信用評等股份有限公司	網 址	http://www.taiwanratings.com
地 址	台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓	電 話	(02)2175-6800

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會計師姓名	江美艷會計師		
地 址	台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	電 話	(02)2725-9988
網 址	http://www.deloitte.com.tw		
律師事務所名稱	一誠聯合法律事務所		
律 師 姓 名	郭惠吉律師		
地 址	台北市大安區信義路三段 106 號 9 樓之 4	電 話	(02)2325-3748
網 址	無		

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所		
會計師姓名	江美艷會計師、林尚志會計師		
地 址	台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	電 話	(02)2725-9988
網 址	http://www.deloitte.com.tw		

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名	黃 仁 昭	代理發言人姓名	高 孟 華
職 稱	副總經理暨財務長	職 稱	企業公共關係部主管
電 話	(03)563-6688	電 話	(03)563-6688
電子郵件信箱	press@tsmc.com	電子郵件信箱	press@tsmc.com

十三、公司網址：<https://www.tsmc.com>

台灣積體電路製造股份有限公司
公開說明書目錄

目錄

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料	1
貳、發行辦法	3
參、資金用途	4

附錄一：本次發行之董事會議事錄

附錄二：證券承銷商總結意見

附錄三：證券承銷商出具不收取退佣之聲明書

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限財團法人櫃檯買賣中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理，應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用途。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

台灣積體電路製造股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額:新臺幣 259,304 百萬元		公司地址: 新竹科學園區新竹市力行六路 8 號		電話: (03) 563-6688	
設立日期: 76 年 02 月 21 日		網址: http://www.tsmc.com.tw			
上市日期: 83 年 09 月 05 日		上櫃日期: 不適用		公開發行日期: 81 年 10 月 30 日	
負責人員: 董事長 劉 德 音		發 言 人: 黃 仁 昭 (副總經理暨財務長) 代理發言人: 高 孟 華 (企業公共關係部主管)			
股票過戶機構: 中國信託商業銀行 代理部		電話: (02) 6636-5566 網址: https://www.ctbcbank.com 地址: 台北市重慶南路一段 83 號 5 樓			
股票承銷機構: 不適用		電話: (02) 8789-8888 網址: http:// www.capital.com.tw			
債券承銷機構: 群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商		地址: 台北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓之 3			
最近年度簽證會計師: 勤業眾信聯合會計師事務所 江美艷、林尚志		電話: (02) 2725-9988 網址: http://www.deloitte.com.tw 地址: 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓			
複核律師: 不適用		電話: - 網址: - 地址: -			
信用評等機構: 中華信用評等股份有限公司		電話: (02) 2175-6800 網址: http://www.taiwanratings.com 地址: 台北市松山區敦化北路 167 號 2 樓			
評等標的	發行公司: 台灣積體電路製造股份有限公司 無□; 有■, 評等日期: 110 年 11 月 16 日 評等等級: twAAA				
	本次發行公司債: 111 年度第 5 期無擔保普通公司債 無■; 有□, 評等日期: - 評等等級: -				
董事選任日期: 110 年 7 月(任期: 三年)		監察人選任日期: 不適用			
全體董事持股比例: 6.56% (111 年 6 月 30 日)		全體監察人持股比例: 不適用			
董事、監察人及持股 10% 以上股東及其持股比例: (111 年 6 月 30 日)					
職 稱	姓 名	持 股 比 例	備 註		
董事長	劉德音	0.05%			
副董事長	魏哲家	0.02%			
董事	龔明鑫	6.38%	行政院國家發展基金管理會代表人		
董事	曾繁城	0.11%			
獨立董事	彼得·邦菲爵士	-			
獨立董事	陳國慈	-			
獨立董事	麥可·史賓林特	-			
獨立董事	摩西·蓋弗瑞洛夫	-			
獨立董事	海英俊	-			
獨立董事	拉斐爾·萊夫	-			
工廠地址:					
二廠、五廠		新竹科學園區園區三路121號	電話: (03)5636688		
三廠		新竹科學園區研新一路9號	電話: (03)5636688		
六廠		南部科學園區南科北路1號	電話: (06)5056688		
八廠		新竹科學園區力行路25號	電話: (03)5636688		
十二廠A廠		新竹科學園區力行六路8號	電話: (03)5636688		
十二廠B廠		新竹科學園區園區二路168號	電話: (03)5636688		
十四廠A廠		南部科學園區南科北路1號之1	電話: (06)5056688		
十四廠B廠		南部科學園區南科九路17號	電話: (06)5056688		
十五廠 A 廠		中部科學園區科雅六路 1 號	電話: (04)27026688		
十五廠 B 廠		中部科學園區新科路 1 號	電話: (04)27026688		
十八廠		南部科學園區北園二路 8 號	電話: (06)5056688		
先進封測一廠		新竹科學園區研新二路 6 號	電話: (03)5636688		
先進封測二廠		南部科學園區南科北路 1 號之 1	電話: (06)5056688		
先進封測三廠		桃園市龍潭區龍園六路101號	電話: (03)5636688		
先進封測五廠		中部科學園區科雅西路5號	電話: (04)27026688		
主要產品: 積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計及光罩製造等代工業務		市場結構: 內銷 16%、外銷 84%		參閱本文之頁次 不適用	
風險事項		不適用		參閱本文之頁次 不適用	
去(110)年度		營業收入: 新臺幣 1,587,415 佰萬元 買賣業: - 佰萬元 加工業: - 佰萬元 製造業: 新臺幣 1,587,415 佰萬元 稅前純益: 新臺幣 663,126 佰萬元 每股盈餘: 23.01 元(稅後基本)		參閱本文之頁次 不適用	
本次募集發行有價證券種類及金額		種類: 無擔保普通公司債; 發行金額為新臺幣壹佰伍拾陸億元整			

發行條件	甲類 4 年 10 個月，利率 1.65%，金額新臺幣 20 億元；乙類 5 年期，利率 1.65%，金額新臺幣 89 億元；丙類 7 年期，利率 1.65%，金額新臺幣 22 億元；丁類 10 年期，利率 1.82%，金額新臺幣 25 億元。(請參閱公開說明書 貳、發行辦法)	
募集資金用途及預計產生效益概述	資金用途：新建擴建廠房設備 預計產生效益：請參閱公開說明書參、資金用途	
本次公開說明書編印日期：111 年 8 月 10 日		刊印目的：發行 111 年度第 5 期無擔保普通公司債(申報用之稿本)
其他重要事項之扼要說明及參閱本文頁次：無		

貳、發行辦法

台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 號函申報生效發行公司債，訂定發行辦法如下

一、債券名稱：台灣積體電路製造股份有限公司111年度第5期無擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）。

二、發行總額：發行總額為新臺幣 156 億元整。依發行期限之不同分為甲類、乙類、丙類及丁類 4 種。甲類 4 年 10 個月無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 20 億元整，乙類 5 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 89 億元整，丙類 7 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 22 億元整，丁類 10 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 25 億元整。

三、票面金額：新臺幣壹仟萬元整。

四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

五、發行期間：甲類：自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 116 年 6 月 日到期。

乙類：自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 116 年 8 月 日到期。

丙類：自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 118 年 8 月 日到期。

丁類：自民國 111 年 8 月 日開始發行，至民國 121 年 8 月 日到期。

六、票面利率：甲類：固定年利率 1.65%。

乙類：固定年利率 1.65%。

丙類：固定年利率 1.65%。

丁類：固定年利率 1.82%。

七、還本方式：各類券均為到期一次還本。

八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。計息基礎依實際天數/該年度實際總日曆天數計算。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。

九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十一、受託人：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

十二、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。

十三、承銷機構：群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商。

十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公告之。

十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

參、資金用途

一、發行公司債資金運用計畫分析

(一) 資金來源：

1. 目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
2. 本計畫所需資金總額：新臺幣 156 億元。
3. 資金來源：發行 111 年度第 5 期無擔保普通公司債。
4. 計畫項目及預定運用進度：

單位：新臺幣億元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
新建擴建 廠房設備	111 年第 3 季	156	111 年度第 3 季
			156

(二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定，應揭露事項：

1. 公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司。
2. 公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣 156 億元整，依發行期限分為甲類、乙類、丙類及丁類 4 種。甲類 4 年 10 個月無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 20 億元整，乙類 5 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 89 億元整，丙類 7 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 22 億元整，丁類 10 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 25 億元整。每張票面金額新臺幣壹仟萬元整。
3. 公司債之利率：本公司債票面利率，甲類為固定年利率 1.65%、乙類為固定年利率 1.65%、丙類為固定年利率 1.65%、丁類為固定年利率 1.82%。
4. 公司債償還方法及期限：各類券均為到期一次還本。
5. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將以營業收入支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6. 公司債募得價款之用途及運用計畫：資金用途為新建擴建廠房設備；資金運用計畫詳本公開說明書第 6 頁。
7. 前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國 111 年 6 月 30 日止，公司債未償還餘額為新臺幣 2,828 億元及美金 20 億元、子公司 TSMC Global Ltd. 發行之公司債美金 65 億元整、及子公司 TSMC Arizona Corp. 發行之公司債美金 80 億元整（截至民國 111 年 8 月 10 日止，公司債未償還餘額為新臺幣 2,967 億元及美金 20 億元、子公司 TSMC Global Ltd. 發行之公司債美金 75 億元整、及子公司 TSMC Arizona Corp. 發行之公司債美金 80 億元整）。
8. 公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。
9. 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國 111 年 6 月 30 日止，核定股本額為新臺幣 280,500,000,000 元整，每股面額新臺幣 10 元整，實收資本總額為新臺幣 259,303,804,580 元整，分為 25,930,380,458 股。
10. 公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：截至民國 111 年 6 月 30 日止，該項餘額為新臺幣 2,510,462,125 仟元。

11. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。
 12. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：
本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
 13. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
 14. 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽定之承銷契約辦理相關承銷及應募等事宜。
 15. 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
 16. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
 17. 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
 18. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
 19. 附認股權者，其認購辦法：不適用。
 20. 董事會之議事錄：請參閱附錄之董事會會議紀錄。
 21. 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
- (三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。

1. 本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行金額為新臺幣156億元，每張面額為新臺幣壹仟萬元，按面額發行。本公司債採對外公開承銷之方式，洽特定人認購，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

2. 本次發行公司債之必要性評估：

本次發行公司債之資金將用於購置晶圓十八廠之機器設備，以因應公司長期成長所需，故本次發行公司債應屬必要。

3. 本次發行公司債之合理性評估：

本次公司債採固定利率發行，由於目前國內長期利率水準尚屬低廉，故發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

4. 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市（櫃）公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目	有利因素	不利因素
----	------	------

債權	普通公司債	1.可取得中、長期穩定之資金。 2.借貸成本相對低廉。 3.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 4.債息列為費用，具節稅效果。 5.運用財務槓桿，提高股東權益。	1.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 2.將使負債比率增加。
	銀行借款	1.資金調度運用彈性較大。 2.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 3.債息列為費用，具節稅效果。 4.運用財務槓桿，提高股東權益。	1.較不利於長期資金之取得 2.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 3.將使負債比率增加。
	可轉換公司債	1.因附有轉換權利，票面利率較公司債低。 2.相較於股權籌資，可延緩或不造成每股盈餘及股權稀釋。	1.轉換前將使負債比率增加。 2.轉換後將稀釋每股盈餘及股權。
股權	現金增資	1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。
	美國存託憑證(ADR)	1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 3.募資對象以國外法人為主，可免增資新股釋出，致國內流通股數膨脹，對股價產生不利影響。	1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。 3.發行成本較高，為達成規模經濟效益，募資額度不宜過低。

(2) 對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘及股權稀釋。由於目前市場利率處於低點，故利息負擔尚屬合理，對每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：本次發行價格參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益

- 收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構（含總成本及單位成本）、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：

(1) 資金運用概算：

單位：新臺幣億元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度
			111 年第 3 季
新建擴建廠房設備	111 年第 3 季	156	156

- 預計可增加之產銷量、值、毛利、營業淨利及資金回收年限(表列資料以計畫之預計可能產生效益年度起至預計可收回資金年限止)

單位：千片；新臺幣億元

年 度	項 目	生 產 量	銷 售 量	銷 售 值	毛 利	營 業 淨 利
112	晶圓十八廠	11	11	43	25	21
113	晶圓十八廠	20	20	77	45	37
114	晶圓十八廠	20	20	77	45	37
115	晶圓十八廠	20	20	77	45	37
116	晶圓十八廠	20	20	77	45	37

預估資金回收年限：5年

(3) 產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：本次資金運用為新建、擴建廠房設備，增加產銷量，非針對產品品質改善或其他可能產生之效益。

2. 轉投資其他公司者應列明事項：不適用。
3. 充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：不適用。
4. 如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。
5. 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

台灣積體電路製造股份有限公司

董事會會議記錄

(中華民國一百一十一年度第一次董事常會)

(節錄本)



時 間： 壹、中華民國一百一十一年二月十四日（下午4:00）

貳、中華民國一百一十一年二月十五日（上午9:00）

地 點： 新竹科學園區新竹市力行六路八號（視訊會議）

親自出席董事共十人：劉德音、魏哲家、曾繁城、Peter L. Bonfield、陳國慈、
Michael R. Splinter、Moshe N. Gavrielov、海英俊、
L. Rafael Reif、龔明鑫

主 席： 劉德音 博士

記 錄： 方淑華

列席及報告人員：（略）

（前略）

十、 決議事項

（第一項至第十九項略）

第二十項： 提請本會核准於（1）不高於新台幣 60,000,000,000 元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以及（2）不高於美金 1,000,000,000 元之額度內於台灣國際債券市場分次募集美元無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求，並核准就上述公司債向主管機關申請發行，於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易；另請授權董事長或其指定之人決定上述公司債之主要發行條件、發行時間、計畫項目、預計可能產生效益及其他相關事項。

經提案表決全體出席董事一致通過決議如下：

決議：照案通過。

（後略）

十一、 經詢無其他臨時動議，本會議程結束。

承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

台灣積體電路製造股份有限公司本次為發行 111 年度第 5 期無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣 156 億元整，分為甲類 4 年 10 個月、乙類 5 年期、丙類 7 年期及丁類 10 年期 4 種，每張面額均為新臺幣壹仟萬元壹種，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，台灣積體電路製造股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

台灣積體電路製造股份有限公司

群益金鼎證券股份有限公司

董事長 王濬智

承銷部門主管 張嘉紋



中 華 民 國 111 年 8 月 10 日

聲明書

本公司受台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電)委託，擔任台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台積電本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：王濬智



日期：111 年 8 月 10 日

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長：劉 德

